

TOP DuNC CU

TOP DuNC CU

レベリング性に優れ、ピットが生じにくい装飾用硫酸銅めっき添加剤

Additive for acid copper plating with high leveling power, can reduce pit

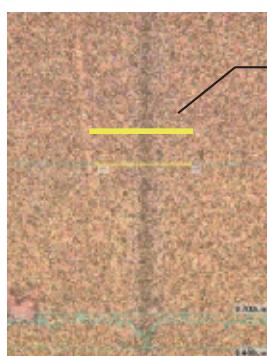
- 素材キズの埋め込み性に優れ、美しい外観が得られる
Can cover dent areas finely, can get beautiful appearance

- スラッジ発生量が少ない
Reduce sludge amount

- ピットを生じにくい
Can reduce pit

- 浴管理が容易
Easy bath control

優れたレベリング性 Excellent leveling power



深さプロファイル測定箇所
Depth profile measuring spot
Rz : 2.518μm(最大深さ)
Maximum depth

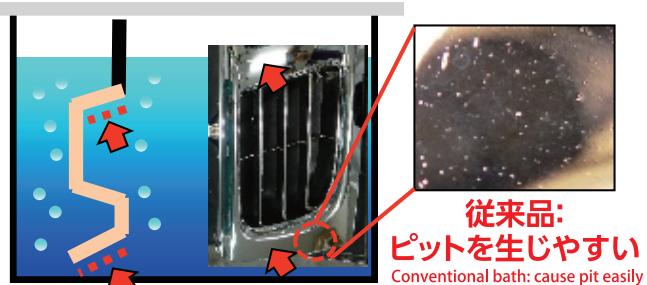
硫酸銅めっき
Acid copper plating



ABS成形品のウェルド部深さプロファイル(エッチング18分)
Molded ABS resin, weld part depth profile (Etching: 18min)

素材キズをレベリングし、美しい外観を実現
Can cover weld part finely, can get beautiful appearance

ピットを生じにくい Prevent pit



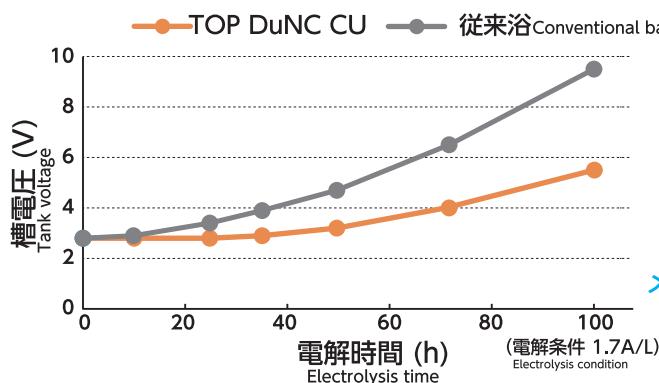
エア搅拌が弱く、電流密度が高くなる
Weak air agitation, high current density



ピットを防ぎ、外観が向上
Prevent pit, improve appearance

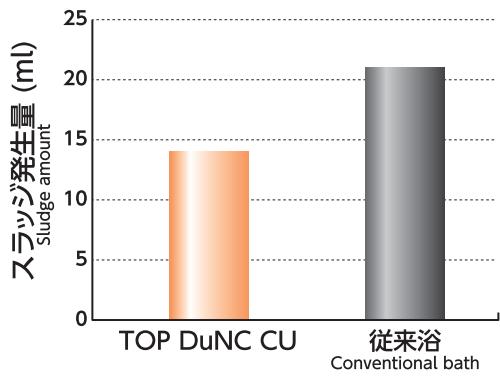
槽電圧の上昇を抑え、スラッジの発生を抑制する

Can stop tank voltage increase, prevent sludge occurrence



100時間後の
スラッジ発生量を
メスリンダーで測定
Measure sludge amount
after 100hour test

電解にともなう槽電圧の変化 Tank voltage change by electrolysis



スラッジ発生量の比較 Comparison of sludge amount